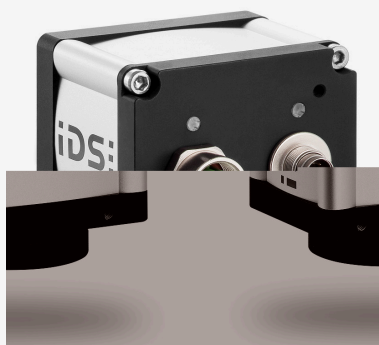


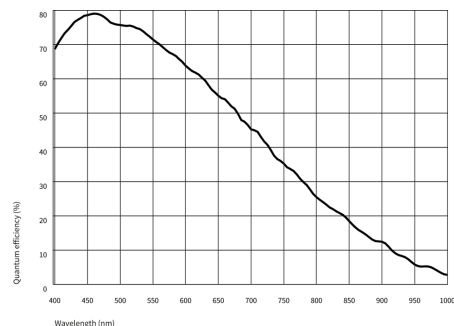
■ 量産中
このカメラモデルは量産中で長期にわたりご使用いただけます。



仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS モノクロ
シャッター	グローバルシャッター
特性	リニア
解像度/ピクセル	8 MP
有効画素数	8.13 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	2856 x 2848 ピクセル
アスペクト比	1:1
ADC	12 bit
色深度 (カメラ)	12 bit
光学センサークラス	2/3"
撮像面積	7.825 mm x 7.804 mm
光学センサーの対角	11.05 mm 2/3"
画素サイズ	2.74 μm
CRA (主光線角)	0 °
メーカー	Sony
センサーモデル	IMX546-AAMJ-C
ゲイン (マスター/RGB)	16x/-
AOI 水平	同じフレームレート
AOI 垂直	増加したフレームレート
AOI 画像の幅、ステップ幅	256 / 2
AOI 画像の高さ、ステップ幅	1 / 1
AOI 位置グリッド (水平/垂直)	2 / 1
ビニング水平	増加したフレームレート
ビニング垂直	増加したフレームレート
ビニング手法	水平: 加算 / 垂直: 加算
ビニング係数	2x2
デシメーション(サブサンプリング) 水平	増加したフレームレート
デシメーション(サブサンプリング) 垂直	増加したフレームレート
デシメーション(サブサンプリング) 手法	M/C 自動



モデル

フレームレートフリーランモード	15 fps
フレームレートトリガー（連続）	15 fps
フレームレートトリガー（最大）	16 fps
露出時間（最小～最大）	0.023 ms - 2000 ms
長時間露出（最大）	120000 ms
ラインレート・トリガーモード（ラインスキャン）	551 1/s
1フレームあたりのライン数（ラインスキャン）	8000
消費電力	2 W - 4 W
画像メモリ	128 MB

HDR

モード	Sequencer
-----	-----------

環境条件

下記の温度は、デバイス外部の温度を基準としています。

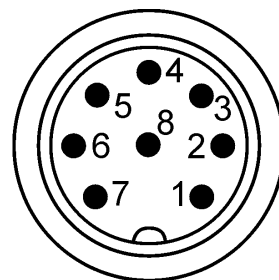
動作時の許容デバイス温度	-20 ° C - 55 ° C / -4 ° F - 131 ° F
保管時の許容周囲温度	-20 ° C - 60 ° C / -4 ° F - 140 ° F
湿度（相対湿度、結露なし）	0 % - 100 %

コネクタ

インターフェースコネクタ	GigE M12、ねじ止め式
I/O コネクタ	Binder 製 8 ピンコネクタ（Binder シリーズ 712:09-0427-020-08）
電源	12 V ~ 24 V または PoE

ピン割り当て I/O コネクタ

1	オプトカブラありのトリガー入力 (+) - Line 0
2	入力電源 (VCC)、12 ~ 24 V DC
3	汎用入出力 (GPIO) 1 - Line 2
4	接地 (GND)
5	オプトカブラありのフラッシュ出力 (+) - Line 1
6	オプトカブラありのフラッシュ出力 (-) - Line 1
7	オプトカブラありのトリガー入力 (-) - Line 0
8	汎用入出力 (GPIO) 2



設計

レンズマウント	C-マウントレンズ
保護構造	IP66, IP67, IP69, IPx9K
外形寸法	41.0 mm x 53.0 mm x 42.7 mm
重量	178 g
ハウジング素材	アルミニウム

Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。

このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

画像取得	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	✓
	Trigger controlled exposure	✓
	Denoiser	✓
	Long exposure	✓
	Line scan	✓
フラッシュ	Flashing	✓
	PWM flashing	✓
画像調整	Auto exposure	✓
	Auto gain	✓
	Auto whitebalance	-
	Color correction	-
	Gamma	✓
	LUT	✓
	Mirror/flip	X/Y
統合画像処理	Pixel formats	Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	2x2
	Binning (FPGA)	✓
	Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.
その他	IP settings	✓
	Bandwidth management	✓
	Chunks	✓
	Sequencer	✓
	PTP	✓
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	3.31